

キモテクト

液状レジスト用保護フィルム

For Liquid Solder Resist

PA8X

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

液状レジストが付着しにくく、クリーニングが容易
糊残りが無く再剥離が可能

キモテクト液状レジスト用のスタンダードタイプ

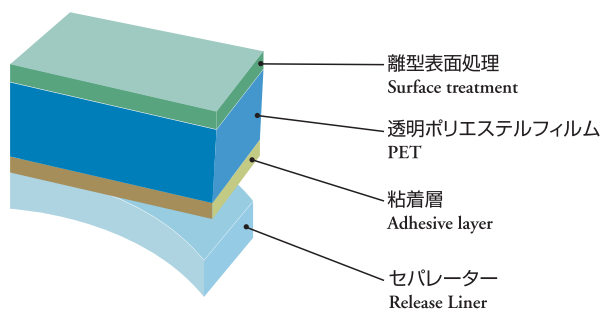
PA8X can be easily removed from the surface of the phototools and is repealable without any remnants of adhesive.
PA8X is a standard type for the Liquid Solder Photo Resist Series.

PA8XM

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

マットタイプ使用により密着性、真空引きが向上

A matted surface improves adhesion and vacuum pressure.



特性 Properties

	PA8X	PA8XM
全光線透過率(%)*1 Total Light Transmittance	92.9	92.2
平行光透過率(%)*1 Parallel Light Transmittance	90.8	85.6
紫外線透過率*2(%/365nm) UV Light Transmittance	87.9	89.5
紫外線透過率*2(%/420nm) UV Light Transmittance	87.4	90.0
Haze(%)*1	2.1	7.2
粘着力(対PET) Adhesive Force for PET	2.5N/25mm	2.6N/25mm

*1: JIS-K7105に準じて測定。セパレーターは含まれていません。

*2: 島津製作所製、UV-3101PCで測定。セパレーターは含まれていません。

*1: JIS-K7105 without Release Film. *2: Simazu UV-3101PC without Release Liner.

※本カタログに記載のデータは代表値であり、規格値ではありません。

株式会社 きもと
電子工業材料部門

KIMOTO CO., LTD
Electronic and
Industrial Materials Division
TEL.03 (3350) 0704
FAX.03 (3350) 8755

URL
<http://www.kimoto.co.jp>